

形状：DIP

〈目次〉

1. 内部構造図及び材料	1 / 3 page
2. 包装仕様	2 / 3 page
3. 保管環境と実装までの保存期間	2 / 3 page
4. 標印ロット番号判読法	3 / 3 page
5. 参考ランドパターン	3 / 3 page
6. はんだ付け条件	3 / 3 page

1. 内部構造図及び材料

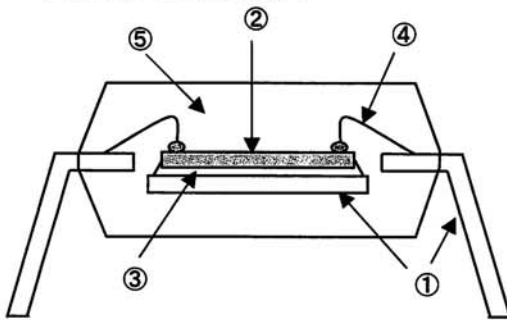


図1 内部構造図

No.	名称	材料
①	リードフレーム	DIP28:鉄/ニッケル合金(外装無鉛半田メッキ) DIP28以外:銅合金(外装無鉛半田メッキ)
②	ダイ	シリコン
③	ダイアタッチ	銀入りエポキシ樹脂
④	ワイヤー	金
⑤	モールド	エポキシ樹脂

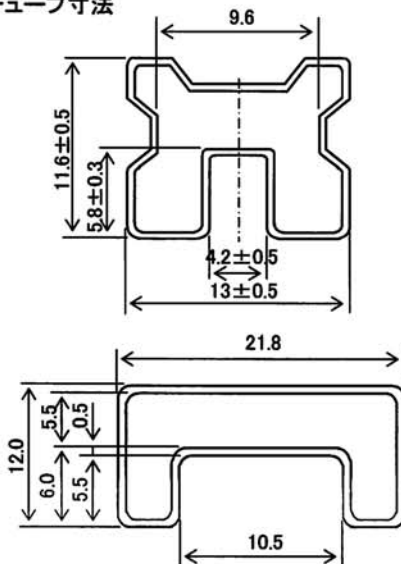
2. 包装仕様

2. 1. 包装形態、包装数量、包装方向

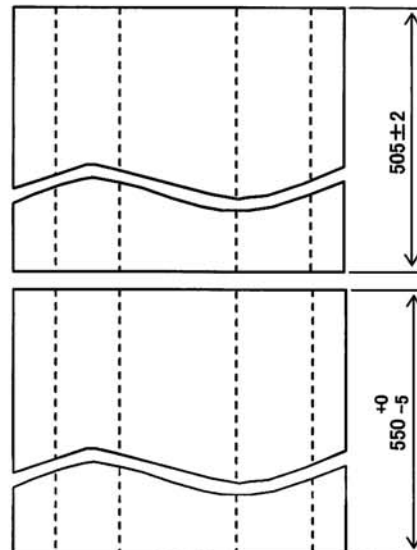
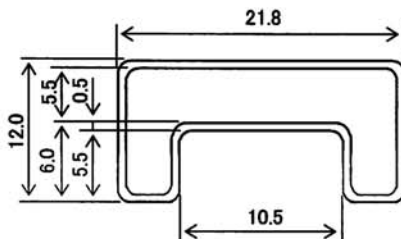
包装形態	コンテナチューブ
包装数量	末尾表を参照して下さい。
包装方向	1コンテナチューブ内での製品方向は一定

2. 2. コンテナチューブ寸法

DIP-T8
DIP14
DIP16
DIP18
DIP20
DIP22



DIP28



単位 ; mm

図2 コンテナチューブ寸法図

2. 3. ラベル表示

図3の内容を記載したラベルを、個装箱に貼付しています。

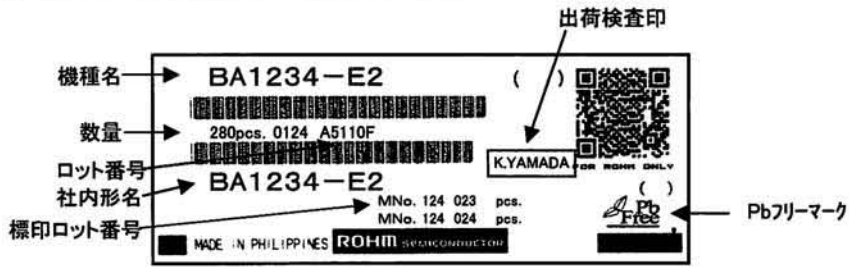


図3 ラベル表示内容

2. 4. 包装方法

個装箱の寸法は末尾表を参照して下さい。

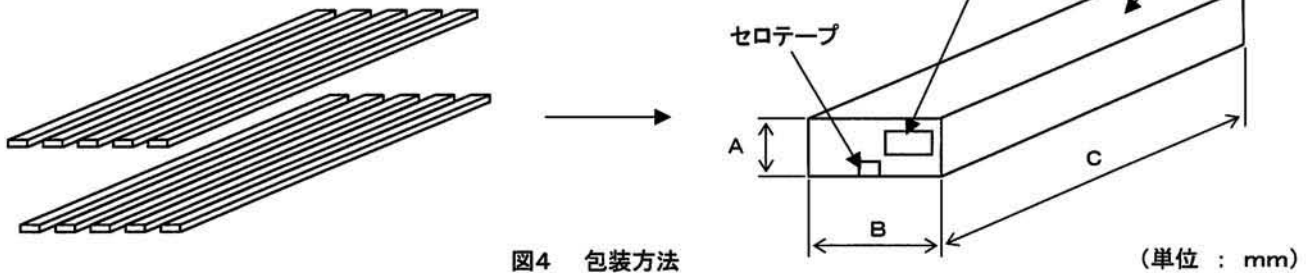


図4 包装方法

(単位 : mm)

2. 5. 梱包形態

梱包箱は図5の寸法となっています。この中に個装箱が最大で3箱入っています。

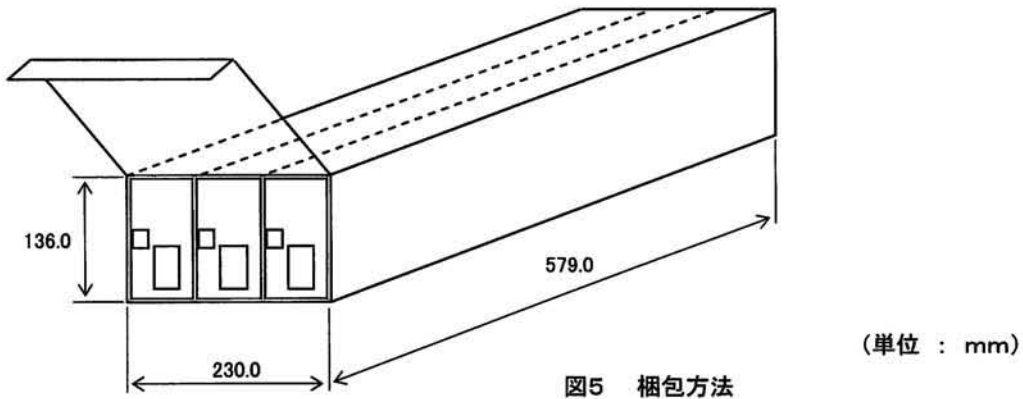


図5 梱包方法

(単位 : mm)

2. 6. 包装材料

使用している包装材料を下表に示しております。

材料名	材質
コンテナチューブ	PVC
ストッパー	PVC
個装箱	段ボール紙
梱包箱	段ボール紙

3. 保管環境と実装までの保存期間

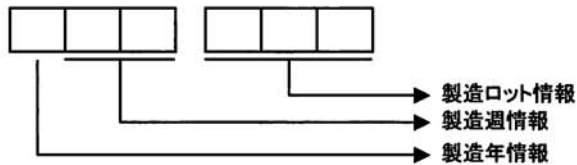
3. 1. 製品の保管環境

製品は温度5~30°C、相対湿度40~70%RHの場所で保管して下さい。

3. 2. 保存期間

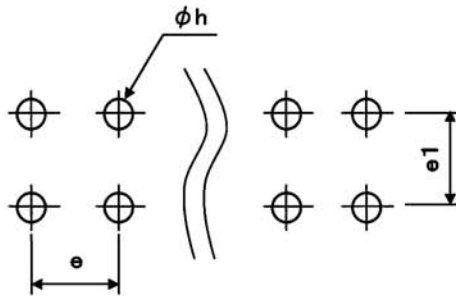
実装までの保存保証期間は1年です。

4. 標印ロット番号判読法



5. 参考ランドパターン (実際の設計に当たっては、状況に合わせて適正化を図ってください。)

単位 : mm



PKG	ランドピッチ e	ランド間隔 e1	ランド径 φh
DIP-T8	2.54	7.62	0.80
DIP14	2.54	7.62	0.80
DIP16	2.54	7.62	0.80
DIP18	2.54	7.62	0.80
DIP20	2.54	7.62	0.80
DIP22	2.54	7.62	0.80
DIP28	2.54	15.24	0.80

6. はんだ付け条件

6.1. フローはんだ実装推奨条件

フローはんだでの耐熱保証可能な実装条件を以下にします。

処理工程	条件	
	温度	時間
予熱部	120°C~150°C	60sec MAX
半田槽	260°C±3°C	12secMAX

注)はんだ槽時間は、ダブルウェーブソルダリングの場合、合計時間にて規定します。

6.1.1 フローはんだ実装における注意事項

- (1) 浸漬位置はストッパーのあるものはストッパーまで、ストッパーのないものは本体から1.5mm以上離れた位置として下さい。
- (2) はんだ実装後のフラックス残渣は、部品や基板配線の信頼性に影響を与えるため、十分な洗浄を推奨いたします。
- (3) フローはんだ実装では、リード間でのはんだブリッジが発生する可能性がありますので、実装条件等の適正化を図って下さい。

6.2 部分加熱法(ハンダこて使用)の条件

ハンダこてで実装される場合は、各リードに対しハンダこて先温度380°C以下、4秒以内で実装して下さい。

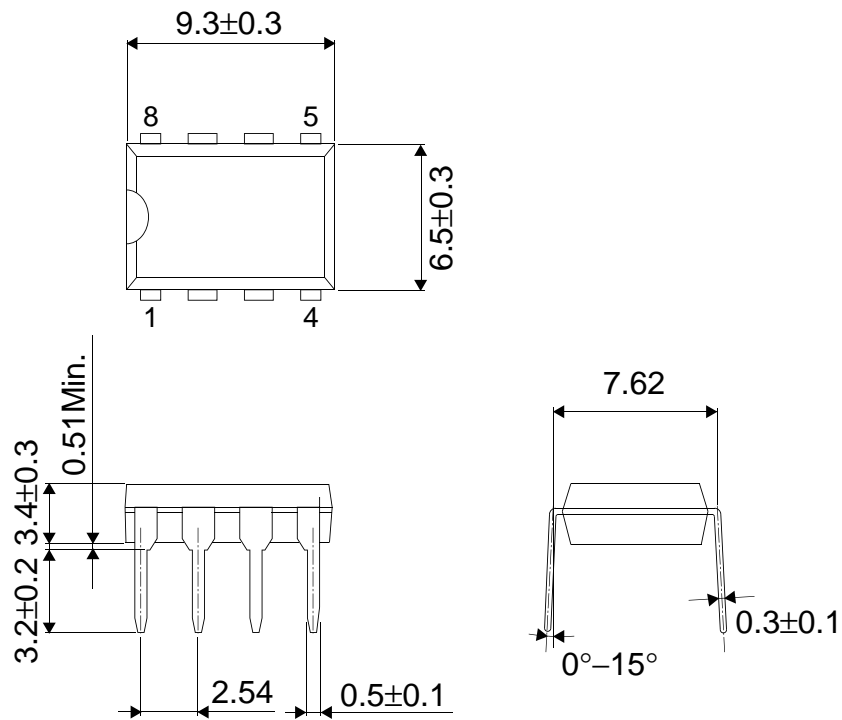
〈 個装箱寸法詳細 〉

〈 乾燥重量 〉

パッケージ	包装数量 (個)	個装箱寸法(単位:mm)			乾燥重量 (単位:g)
		A	B	C	
DIP-T8	2000	70	130	510	0.39
DIP14	1000	70	130	510	1.06
DIP16	1000	70	130	510	1.10
DIP18	1000	70	130	510	1.27
DIP20	600	70	130	510	1.49
DIP22	600	70	130	510	1.72
DIP28	280	60	130	560	4.20

Package Dimensions

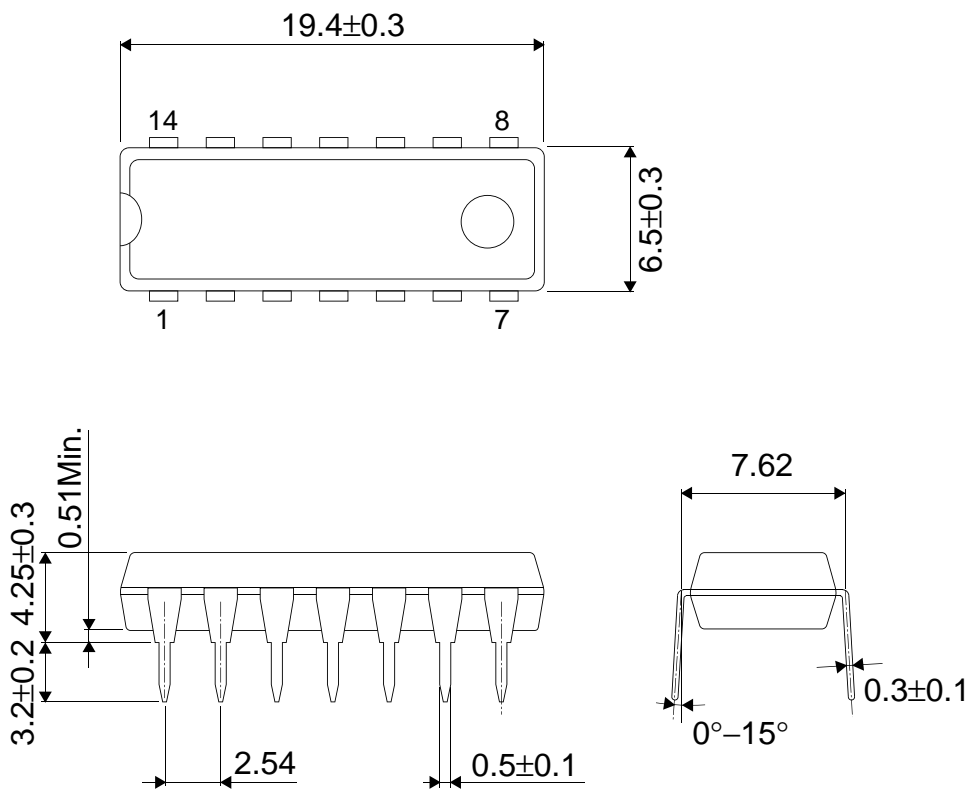
DIP-T8



(Unit : mm)

Package Dimensions

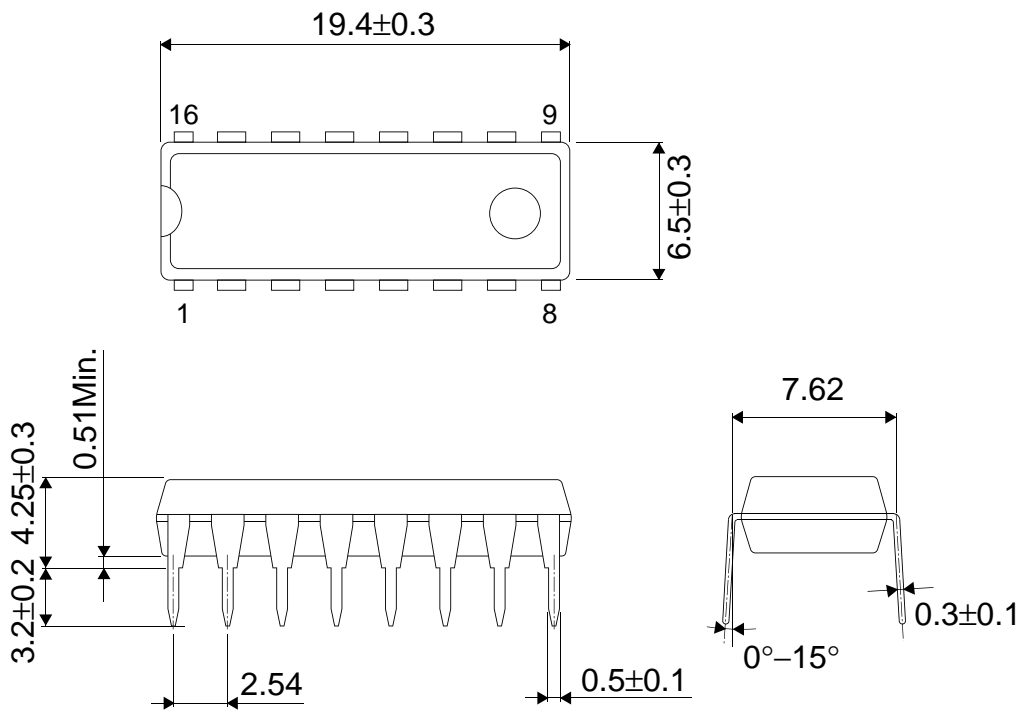
DIP14



(Unit : mm)

Package Dimensions

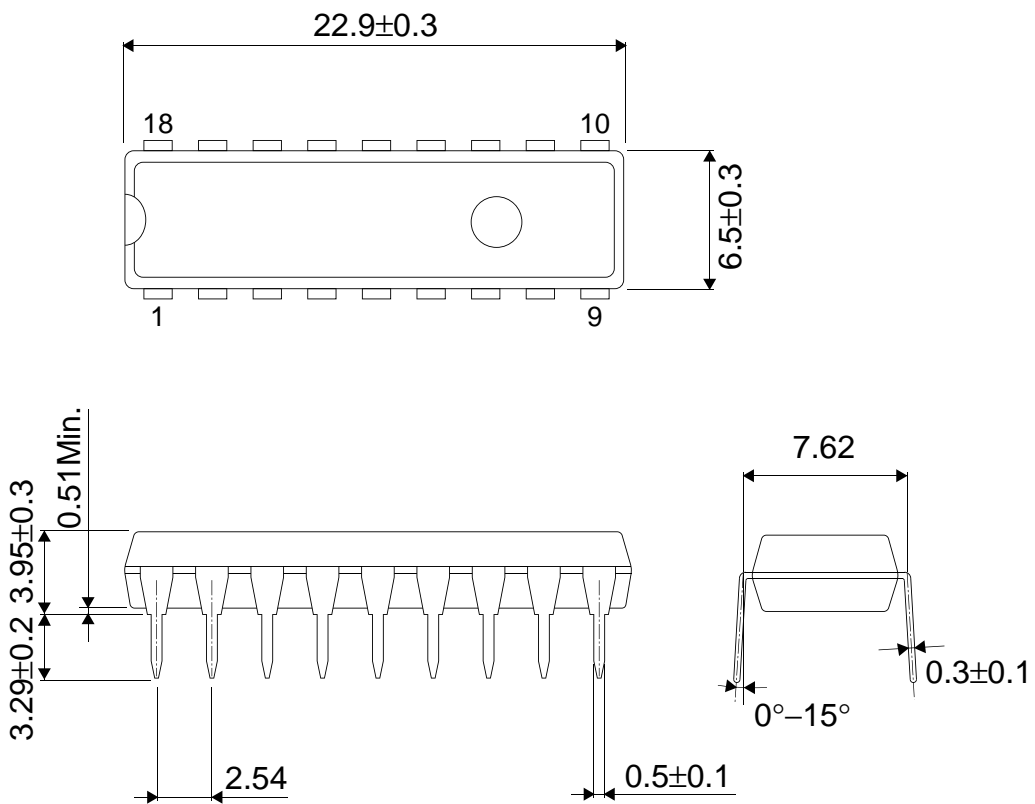
DIP16



(Unit : mm)

Package Dimensions

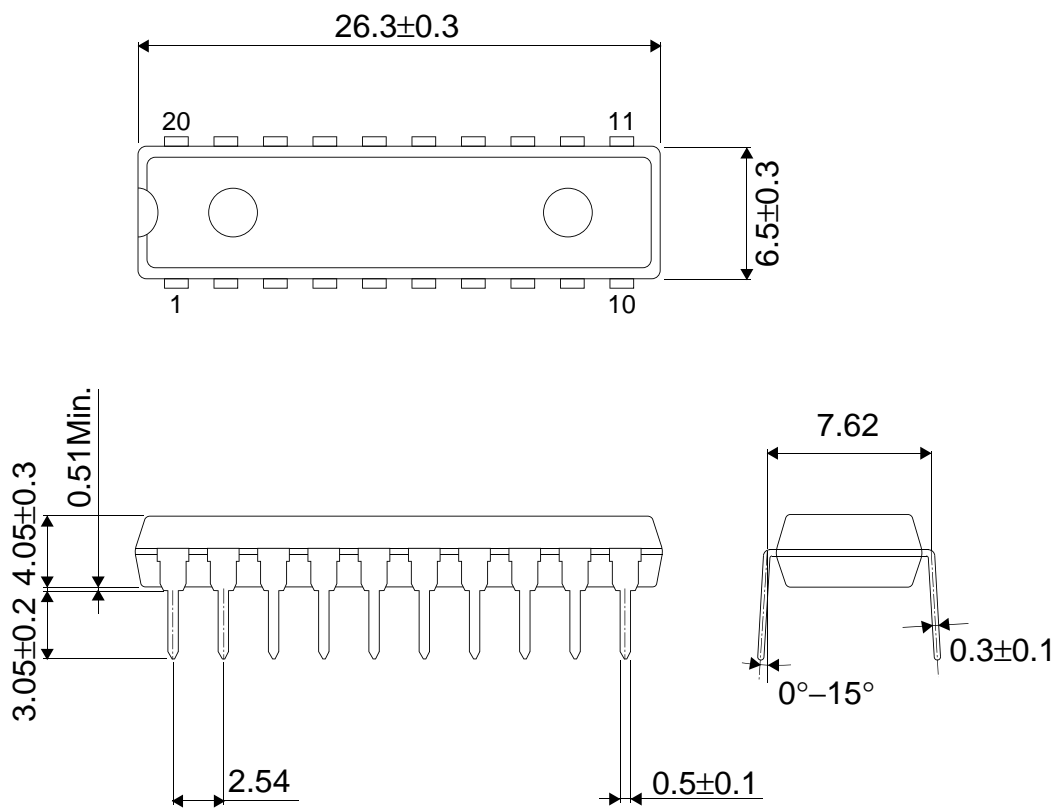
DIP18



(Unit : mm)

Package Dimensions

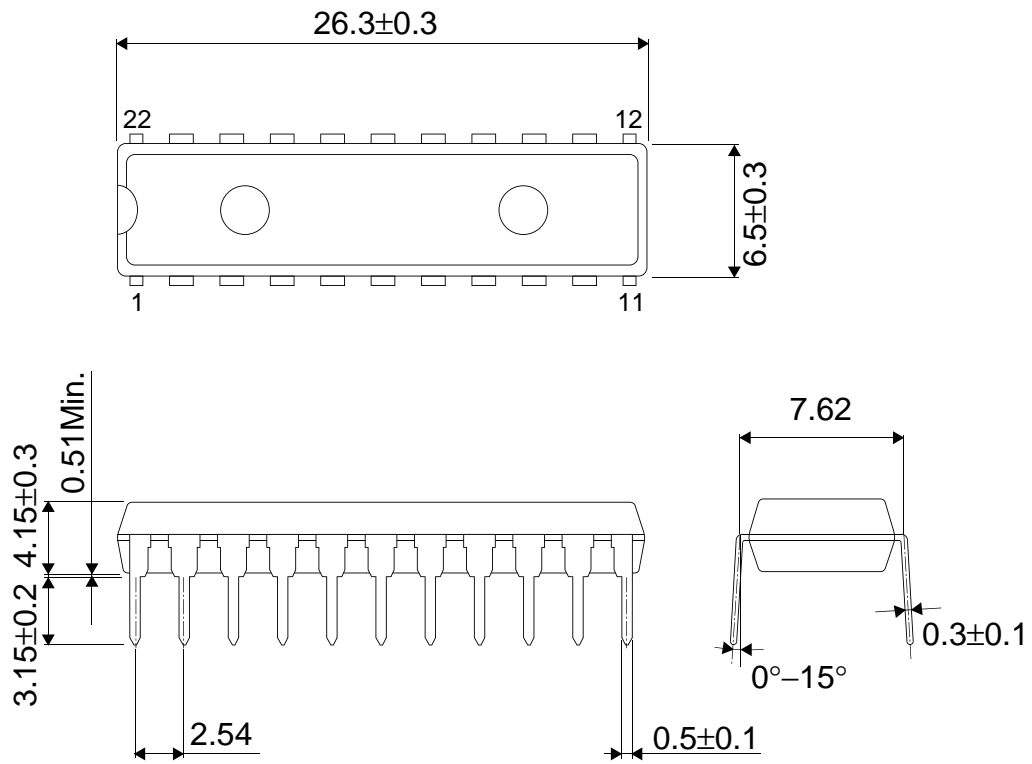
DIP20



(Unit : mm)

Package Dimensions

DIP22



(Unit : mm)

ご 注 意

本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。

本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。

本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に掲載されております製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）への使用を意図しています。

本資料に掲載されております製品は、「耐放射線設計」はなされていません。

ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、種々の要因で故障することもあり得ます。

ローム製品が故障した際、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。

極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのある機器・装置・システム（医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、各種安全装置など）へのご使用を意図して設計・製造されたものではありません。上記特定用途に使用された場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。上記特定用途への使用を検討される際は、事前にローム営業窓口までご相談願います。

本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術を輸出する場合、または国外に提供する場合、同法に基づく許可が必要です。



ローム製品のご検討ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>